

附件一

电子元器件自查承诺书

依据 ZKB 3101-001-2022《军用电子元器件自主可控评估通用准则》和 ZKB 3101-002-2024《武器装备使用国产电子元器件“伪、空、包”产品判定准则(试行)》的相关要求，我单位针对研制生产的电子元器件产品开展自主可控等级和“伪、空、包”情况自查及评估。结果如下：

自查产品共6项，其中自主可控 A 级0项、B 级6项、C 级0项、C*级0项、D 级0项、E 级0项；伪国产化0项、包装国产化0项、空心国产化0项。

电子元器件“伪、空、包”审查基本信息填写表详见附表一；电子元器件使用 IP 核情况、原材料和零部件、工艺流片等基本情况填写表详见附表二。

我单位承诺以上内容真实有效，自愿承担一切后果。

特此承诺。



2026 年 01 月 13 日

附表一

电子元器件“伪、空、包”审查信息一览表

序号	元器件名称 ^a	型号规格 ^b	生产厂商 ^c	自主可控等级 ^d	是否“伪国产化” ^e		是否“包装国产化” ^e		是否“空心国产化” ^e		备注 ^e
					是/否	情况说明	是/否	情况说明	是/否	情况说明	
1	通用运算放大器	JLM358AXK	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
2	通用运算放大器	JLM358AXQ	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
3	通用运算放大器	JLM358AXK(W)	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
4	通用运算放大器	JLM358AXQ(W)	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
5	通用运算放大器	LM358AXK	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
6	通用运算放大器	LM358AXQ	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	

填表说明:

^a. 应是元器件全称, 与详细规范或产品技术资料上的名称相符;^b. 应填写元器件完整型号规格;

填报单位(盖章)



法定代表人(签章): 沈慧明

填表人(签字): 侯仕颖

电话: 13699386074

填报日期: 20260113

^c. 应填写元器件生产厂商中文全称，勿填写代理商；

^d. 按照 ZKB 3101-001-2022《军用电子元器件自主可控评估通用准则》执行，分为 A、B、C、C*、D、E 六个等级，针对为军选民用计算机设备等配套的中央处理器、图形处理器、网络交换芯片、网络处理器芯片、网络控制器芯片、存储控制器芯片按照 GJB 9530 执行；

^e. “伪、空、包”应按照 ZKB3101-002-2022 标准执行。若为“是”时，则需要“情况说明”写明判别因素；若为“否”时，则填“无”；

^f. 若存在其他需要说明的情况，可在备注栏填写。



填报单位（盖章）

法定代表人（签章）：沈学明

填表人（签字）：侯仕颖 电话：13699386074 填报日期：20260113

附表二

电子元器件基本信息表

序号	元器件名称 ^a	型号规格 ^b	使用 IP 核情况 ^c				原材料和零部件 ^d				流片工艺 ^e		备注
			名称	类型	来源单位	境内/境外	名称	是否“核心”/“关键” ^e	来源单位 ^f	境内/境外	工艺名称	境内/境外	
1	通用运算放大器	JLM358AXK	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.5um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
2	通用运算放大器	JLM358AXQ	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.5um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
3	通用运算放大器	JLM358AXK(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.5um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
4	通用运算放大器	JLM358AXQ(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.5um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
5	通用运算放大器	LM358AXK	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.5um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
6	通用运算放大器	LM358AXQ	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.5um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				

填报单位(盖章)



法定代表人(签章): 汤学明

填表人(签字): 侯仕颖

电话: 13699386074

填报日期: 20260113

填表说明:

- ^a. 应是元器件全称, 与详细规范或产品技术资料上的名称相符;
- ^b. 应填写元器件完整型号规格;
- ^c. 仅适用于半导体集成电路, 应填写 IP 核类型, 包括“软核”“固核”“硬核”;
- ^d. 本表中应填报的原材料和零部件应根据实际情况填写, 至少包含 ZKB 3101-002-2022 标准附录 A 中内部零部件或原材料, 同时也应包含外壳、引出端、键合丝等, 不包含灌封料等生产过程材料;
- ^e. 应根据 ZKB 3101-002-2022 标准附录 A 填写“核心”或“关键”, 非“核心”或“关键”原材料和零部件此项不填;
- ^f. 应根据实际设计单位或生产商情况填写, 不能按代理商填写; 对来源不明的, 应填写“来源不明”, 具体判定时视为“境外”;
- ^g. 仅适用于半导体集成电路, 应填写流片工艺名称, 如 45nmBCD 工艺等, 必要时在备注中填写流片厂商信息。

填报单位(盖章)



法定代表人(签章): 沈慧明

填表人(签字): 侯仕颖 电话: 13699386074 填报日期: 20260113

附表三

国产电子元器件自主可控自查评分表（V4.0版）

器件名称	通用运算放大器	质量等级	工业级	封装形式/尺寸	SOP8,TSSOP8	是否鉴定	是			
型号规格	LM358AXQ,LM358AXQ	执行标准	Q/TLX51840-2025,Q/TLX51841-2025	鉴定单位	无锡泰连芯科技有限公司					
该器件属于	☐ 伪国产化 ☐ 空心国产化 ☐ 包装国产化 ☒ 不属于“伪空包”									
评估要素 (权重)	评估指标	评估项目					百分制 原始分	换算 得分		
关键原材料 和零部件 (Q1)	关键原材料 和零部件 (100%)	全部为自研或从境内内资生产商采购（80~100分）					80	80		
		从境内中外合资（非外资控股）生产商采购，但不涉及境内中外合资（外资控股）或境内外资或境外采购（70~79分）								
		从境内中外合资（外资控股）或境内外资生产商采购，但不涉及境外生产商采购；或大部分为自研或境内采购，其余从境外生产商采购（60~69分）								
		少部分为自研或境内采购，其余从境外生产商采购（50~59分）								
设计开发 (Q2)	产品设计技术 (80%)	全部从境外生产商采购（0~49分）					79	79.4		
		全部设计为本厂商自主技术（100分）								
		部分设计（含核心功能设计）为本厂商自主技术，其余为境内其他厂商技术（80~99分）								
		全部设计采用境内其他厂商技术（70~79分）								
		大部分设计（含核心功能设计）为本厂商自主技术或采用境内其他厂商技术或在境外厂商技术基础上二次开发，其余设计直接采用境外厂商技术（60~69分）								
		大部分设计（或核心功能设计）直接采用境外厂商技术，其余为本厂商自主技术或境内其他厂商技术（50~59分）								
	产品研发团队 (10%)	全部设计直接采用境外厂商技术（0~49分）					80			
		研发团队全部由本厂商且为境内人员组成。研发团队具备长期稳定的后续支持能力（100分）								
		研发团队涉及外协但全部由境内人员组成。研发团队具备长期稳定的后续支持能力（80~99分）								
		研发团队含境外人员，但境内人员掌握全部关键技术。研发团队具备长期稳定的后续支持能力（70~79分）								
		研发团队含境外人员，但境内人员掌握大部分关键技术。研发团队具备长期稳定的后续支持能力（60~69分）								
		研发团队含境外人员，且境内人员仅掌握少部分关键技术。研发团队后续支持能力较差（50~59分）								
产品专用设计 软件(10%)	研发团队含境外人员，且境内人员不掌握关键技术。研发团队后续支持能力较差（0~49分）					82				
	专用设计软件全部自研或在境内厂商软件基础上进行二次开发（80~100分）									
	专用设计软件全部为直接采用境内厂商软件（70~79分）									
	专用设计软件部分为自研或境内厂商软件，其余涉及直接采用境外厂商软件（60~69分）									
	专用设计软件无自研或境内厂商软件，但部分为在境外软件基础上进行二次开发（50~59分）									
	专用设计软件全部为直接采用境外厂商软件（0~49分）									
工艺制造 (Q3)	关键工艺生 产线情况 (95%)	均在本厂商生产线或境内其他内资厂商生产线上进行（80~100分）					79	79.1		
		涉及境内其他中外合资（非外资控股）厂商生产线，但不涉及境内其他中外合资（外资控股）或境内其他外资或境外厂商生产线（70~79分）								
		涉及境内其他中外合资（外资控股）或境内其他外资厂商生产线，但不涉及境外厂商生产线（60~69分）								
		涉及境外厂商生产线（50~59分）								
	关键工艺技 术、设备及外 包工艺受控 情况(5%)	全部关键工艺均在境外厂商生产线上进行（0~49分）					81			
		均为本厂商自主技术，关键工艺设备/工艺检测设备全部自研或为境内厂商生产（80~100分）								
		部分关键工艺为本厂商自主技术，其余涉及境内其他厂商技术。关键工艺设备/工艺检测设备全部自研或为境内厂商生产。针对外包工艺具有完备的控制手段（70~79分）								
		部分关键工艺为境内自主技术，其余涉及境外厂商技术。关键工艺设备/工艺检测设备涉及境外厂商生产。针对外包工艺具有完备的控制手段（60~69分）								
		部分关键工艺为境内自主技术，其余涉及境外厂商技术。关键工艺设备/工艺检测设备涉及境外厂商生产。针对外包工艺缺乏必要的控制手段（50~59分）								
		全部关键工艺均非境内自主技术。针对外包工艺缺乏必要的控制手段（0~49分）								
		产品检测（包括功能性能测试、环境适应性及可靠性试验，下同）全部在境内进行，产品检测设备全部自研或为境内厂商生产（80~100分）							79	79.7
		产品检测全部在境内进行，产品检测设备部分为境外厂商生产（70~79分）								
产品检测与 供应 (Q4)	产品检测能 力(30%)	产品检测全部在境内进行，产品检测设备全部为境外厂商生产（60~69分）					80			
		产品检测部分在境外进行（50~59分）								
		产品检测全部在境外进行（0~49分）								
	产品供货能 力(70%)	具备至少10年内稳定供货的能力（90~100分）								
		具备至少5年内稳定供货的能力（80~89分）								
		具备至少3年内稳定供货的能力（70~79分）								
		具备至少1年内稳定供货的能力（60~69分）								
		具备至少半年内稳定供货的能力（50~59分）								
		未达到以上要求（0~49分）								
		扣分项	配套软硬件全部由境内自主研发生产。（不扣分）							
			配套软硬件部分由境内自主研发生产。（扣1-4分）							
注：1、半导体集成电路产品，进行“关键工艺生产线情况”评估时，芯片制造、封装受限国内工业现状，只能在境外生产线进行时，可评为60分。 2、Q1、Q2、Q3、Q4权重取值：										
产品类别		Q1 关键原材料和零部件	Q2 设计开发	Q3 工艺制造	Q4 产品检测与供应	总分：79.415				
半导体集成电路、微波半导体集成电路		15%	50%	30%	5%					
混合集成电路及微电路模块、微波混合集成电路及微波组件、半导体分立器件、半导体光电子器件、光电探测与成像器件、真空电子器件、纤维光学有源器件、显示器件、固体激光器、固体继电器、传感器、晶体元器件		25%	40%	30%	5%					
连接器、继电器（固体继电器除外）、电线电缆及组件、开关、纤维光学互连器件及无源器件、光纤光缆及组件、微特电机、电能源、电阻器、电容器、敏感元件、滤波器和网络、磁性元器件、熔断体和熔断器、断路器		25%	35%	35%	5%					
自主 可控 等级 评估	A级	总分≥90且关键原材料和零部件、产品设计技术、关键工艺生产线情况任一项得分≥80								
	B级	总分≥70且关键原材料和零部件、产品设计技术、关键工艺生产线情况任一项得分≥70								
	C级	总分≥60且关键原材料和零部件、产品设计技术、关键工艺生产线情况任一项得分≥60								
	D级	总分≥50且关键原材料和零部件、产品设计技术、关键工艺生产线情况任一项得分≥50								
	E级	总分≤50或关键原材料和零部件、产品设计技术、关键工艺生产线情况任一项得分≤50								

填报单位（盖章）： 法定代表人（签章）： 填报人（签字）： 电话：13699386074 填报日期：20260113